

# JEITA 半導体構造設計サブコミッティ

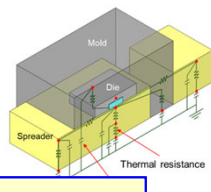
- チップレット時代のAI・半導体の構造設計技術の向上・情報共有と国際標準化
- 会員企業の技術力UPとビジネス機会の増加、政策のタイムリーな伝達

半導体標準化専門委員会

半導体システムソリューション技術委員会

半導体構造設計技術サブコミッティ

熱設計技術WG



熱設計 シミュレーション、モデル、測定法などの精度向上、規格化

国プロ 熱設計 戦略委員会

国プロ熱設計運営・実行、企画立案、アジアの仲間づくり、

国プロ 規格審議委員会

IEC提案規格の審議

6回/年

11回/年

6回/年

11回/年

半導体包装WG

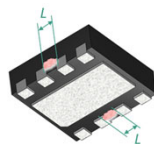


半導体包装国際標準化

パワー半導体パッケージWG

パワー半導体の熱設計、パワーパッケージの外形図

パッケージ外観基準WG



パッケージ外観基準(用語、規格など)の標準化

先端半導体パッケージング技術WG

先端パッケージング情報共有評価法などの国際標準化

メモリスistemWG

JEDEC/JC42, 45内容確認と審議、熱設計と連携

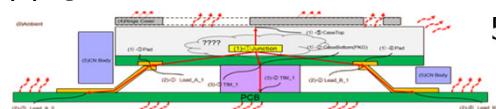
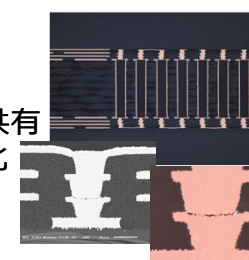
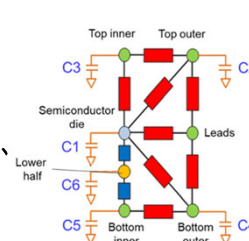
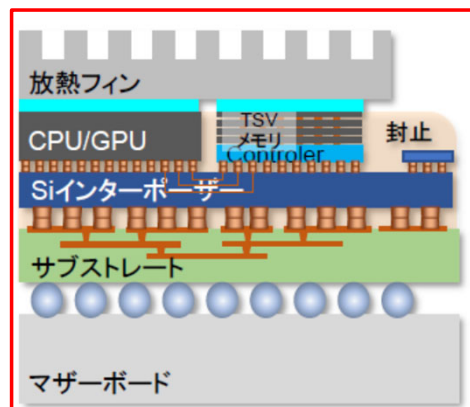
3D半導体/モジュールWG

SC47A/WG7と連携

6回/年

6回/年

■ IEC / SC47D(半導体パッケージング)国内委員会



IEC国際会議でNP提案(11月ロンドン)

※サブコミッティの年会費は事務局にご相談ください。  
※サブコミッティ内のどのWGに、何人参加しても、同一料金です。

お問合せ先 : 一般社団法人電子情報技術産業協会 事業戦略本部事業推進部担当: 岩淵・遠山  
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 E-mail : device3@jeita.or.jp

